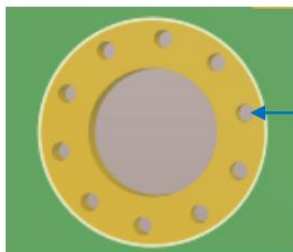


PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES80100_MAIN	V7	1	2023-2-6

参照“ARES80100\_MAIN\_V7\_元件值 PDF”文件；

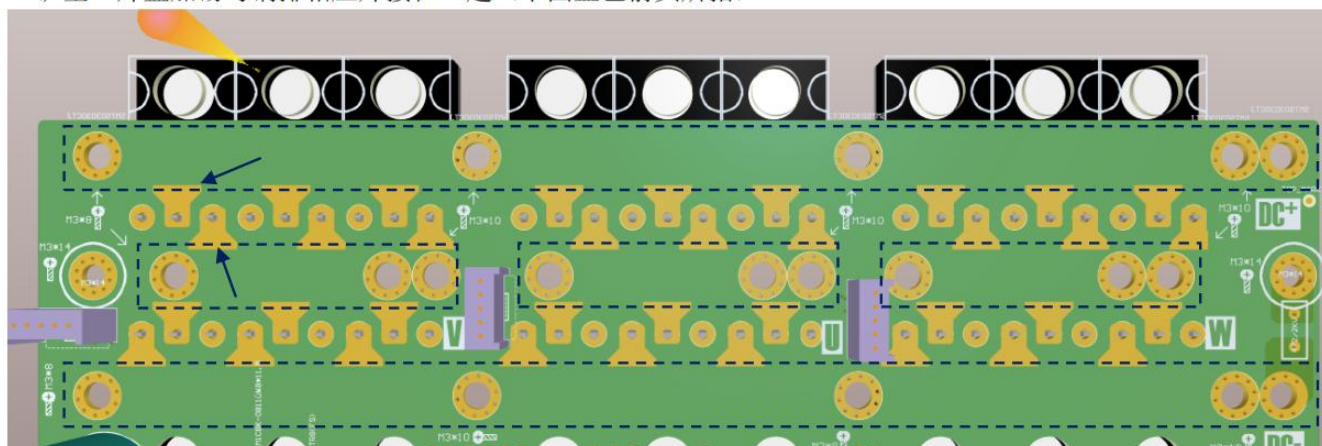
1 铜排固定孔焊接贴片螺母要求

1) 底层贴片螺母的焊盘孔周边一圈的小焊盘的焊锡，漏至顶层不能超过板面（焊锡可以稍欠缺一些）



图示类似位置焊接贴片螺母(在底层)，焊接时漏锡到此面(顶层)，只要其漏锡不超过顶层面即可

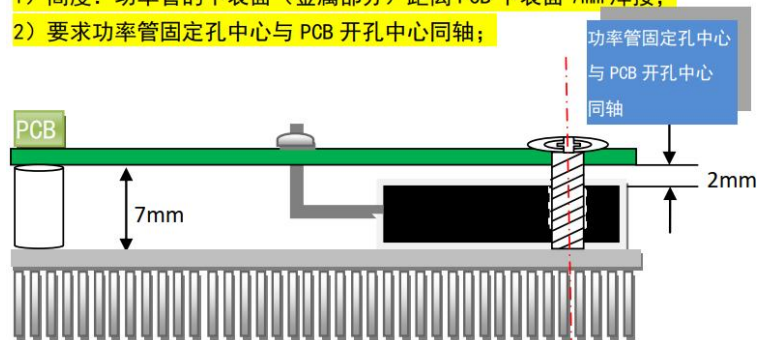
2) 首先把铜排 5 根直铜排（虚线框）固定于 PCBA 上，再把 18 只 MOS 管的其中两个管脚 D,S 极，通过 PCB 上的“铲型”焊盘加锡与铜排相应焊接在一起（下图蓝色箭头所指）



注意：焊接时，焊锡不要高出铜排；

- 2. 贴片螺母 SMTS03030CTJ 个高度为 3mm，均在线路板的底层焊接，紧贴线路板，不能歪斜；
- 3. 红黑两色的风扇引线，分别焊接与 PCB 上 J3 对应的 R 和 B 焊盘孔
- 4. 功率管共计 18 个（T0-247 封装的管子）及 U202（T0-220 封装的管子）焊接要求：

- 1) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 7mm 焊接；
- 2) 要求功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；



- 5. 未标注的，均紧贴线路板焊接；
- 6. 特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	